

2008年12月22日

報道関係各位

DALSA Semiconductor、銅のシリコン貫通ビアを使用した MEMS(マイクロマシン)処理で Alchimer の eG ViaCoat™ 技術のライセンス取得へ

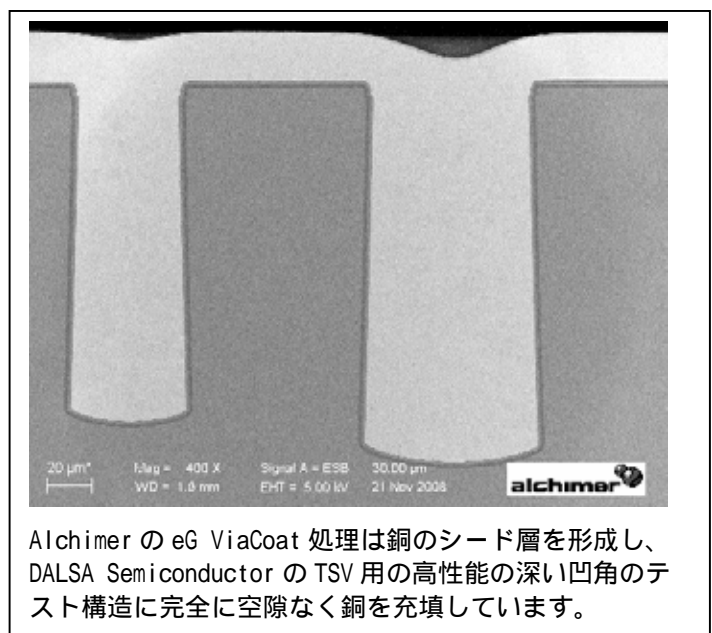
カナダ: プロモント、フランス: マッシー発(2008年12月15日) - DALSA Corporation (TSX: DSA) の一部門として特殊ウエハとカスタムウエハ ファウンドリ・サービスを提供するトップ企業、DALSA Semiconductor は、ナノメートルレベルの金属配線技術のトップ企業 Alchimer S.A. (フランス、マッシー) の eG ViaCoat™ 処理を使用して、シリコン貫通ビア (TSV) 構造上に等角の銅シード層成膜に成功したと発表しました。このテストが成功したことにより、DALSA は Alchimer の技術の使用許諾を受けて MEMS 生産能力を強化する意向です。

DALSA Semiconductor のテクノロジー開発担当バイスプレジデント Luc Ouellet は次のように述べています。「長年に渡って、DALSA Semiconductor は Via-First 方式の TSV を 3D 統合技術に使用して、低コストの MEMS 製品を生産してきました。Alchimer の銅ベースの eG ViaCoat を使用することで、消費者向け MEMS 製品の動作周波数と出力密度が向上し、さらに低い抵抗で TSV による高い熱散逸が達成できます。Alchimer は TSV に戦略的な技術でアプローチしていますが、弊社はこの技術によって費用重視の市場向けに MEMS デバイスを大量生産できるようになります。」

Alchimer の eG ViaCoat は、高度な 3D パッケージング用に使用される TSV の銅シード成膜のための電解皮膜処理で、乾式真空処理に比べて所有コストを 50%以上削減することが可能です。eG ViaCoat は Semicon West 2008 で「Best of the West Award」を受賞しています。

Alchimer は DALSA との使用許諾契約締結を確実にするため、同社の深い凹角を持つ TSV 製品のカバレッジ性能を実証することに成功しました。凹角の TSV は基材の表面の直径が底部より狭くなっています。これはより高速のボッシュ深堀り反応性イオンエッチング (DRIE) 処理で形成される形状の特徴です。eG ViaCoat は凹角の構造で優れたステップカバレッジを示すため、ボッシュ処理で使用する高いエッチ速度が可能になり、DRIE ステップのコストを最大 50%削減できます。より高速の DRIE ステップで、銅シード成膜手順でのコスト削減に加えてコスト削減が可能です。Alchimer は深い凹角の TSV 構造で、空隙のない銅の充填が可能であることも実証しています。

Alchimer の CEO、Steve Lerner はこのように付け加えています。「MEMS のファウンドリ・ビジネスの



Alchimer の eG ViaCoat 処理は銅のシード層を形成し、DALSA Semiconductor の TSV 用の高性能の深い凹角のテスト構造に完全に空隙なく銅を充填しています。

トップ企業であり、しかも革新的な技術と高品質の製品の生産に注力している DALSA との連携を大変楽しみにしています。」

Alchimer について

Alchimer は、革新的な化学製剤、プロセス、半導体ウエハと 3D パッケージング用のシリコン貫通ビアで銅相互接続を形成するナノメートル規模のフィルムの電気化学析出に関する IP の開発と販売を行っています。同社は、Commissariat à l'Énergie Atomique から派生した企業です。2001 年に設立され、フランス研究産業大臣から「First National Award for the Creation of High Tech Companies」を受賞し、Red Herring Top 100 European Company に選ばれています。詳細についてはwww.alchimer.comをご覧ください。

DALSA Corporation について

DALSA は世界中に約 1000 名の従業員を抱え、高性能のデジタル画像と半導体の分野で世界をリードする企業です。1980 年設立の同社は、デジタル画像製品とソリューションの設計、開発、製造、販売を行うとともに、半導体製品と関連業務の提供も行っています。DALSA の中核技術は、特殊集積回路とエレクトロニクス技術、ソフトウェア、高度な技術による半導体ウエハ処理です。画像センサコンポーネント (CCD および CMOS)、デジタルカメラ、ビジョンプロセッサ、画像処理ソフトウェア、MEMS 用半導体ウエハ鑄造業務、高電圧半導体、画像センサ、およびミックスドシグナル CMOS チップなどの製品とサービスを提供しています。DALSA はカナダ、オンタリオ州ワータールローに所在し、銘柄記号「DSA」でトロント証券取引所に上場しています。

< 報道関係者様問い合わせ先 >

Patrick Myles
Vice President, Corporate Communications
DALSA Corporation
Tel: (519) 886-6001 Ext. 2177
Fax: (519) 886-3972
E-mail: patrick.myles@dalsa.com
Web: www.dalsa.com

Emmanuel Guidotti
Alchimer S.A., 15 rue du Buisson aux Fraises, F-91300 Massy, France
E-mail: emmanuel.guidotti@alchimer.com
Tel: +33 1 69 75 43 43
Fax: +33 1 60 11 07 52
Web: www.alchimer.com

株式会社 トークス
橋場 / 平尾
TEL: 03-3261-7715
E-mail: release@pr-tocs.co.jp